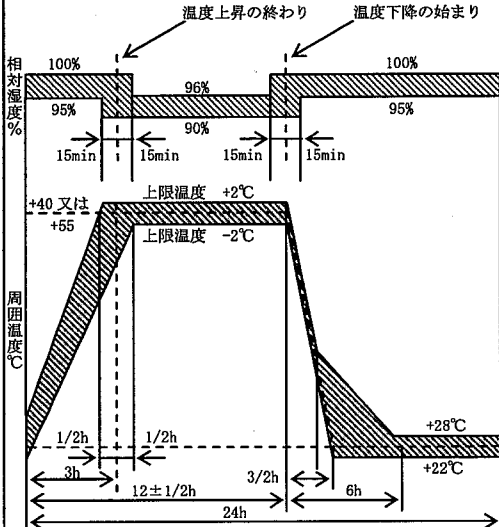


△の数							訂正記事							担当		検図		年月日		△の数							訂正記事							担当		検図		年月日	
①																				③																			
②																				④																			
適用規格														SD Card Specifications Ver 1.0																									
定 格		使用温度範囲		- 2 5 ° C ~ + 8 5 ° C (注 1)										保存温度範囲		- 4 0 ° C ~ + 8 5 ° C																							
		電 圧		A C 1 2 5 V										使用湿度範囲		相対湿度 9 5 % 以下																							
		電 流		0 . 5 A												(ただし、結露しないこと。)																							
性 能																																							
		項 目		試 験 方 法										規 格										QT		AT													
構 造	外観・構造・仕上げ		目視、寸法測定器にて測定する。										図面と合致していること。										○		○														
	表 示		目視にて確認する。																				○		○														
電 気 的 性 能	低電圧、低電流下の接触抵抗 IEC60512-2-2a		開放電圧20 mV、試験電流1 mA で測定する。										100mΩ以下 (初期値) (注2)										○		-														
	耐 電 圧 IEC60512-2-4a		AC 500Vrmsの電圧を 1 分間印加する。										①せん絡・絶縁破壊がないこと。 ②漏洩電流 1 mA以下										○		○														
	絶 縁 抵 抗 IEC60512-2-3a		DC 500Vの電圧を印可し1分以内に測定する。										1000MΩ以上 (初期値)										○		-														
機 械 的 性 能	カード挿入力		スピード 25mm/minにて適合カードで測定する。										初期：10N以下 挿抜寿命後：10N以下										○		-														
	挿抜寿命 (オフィス環境) EIA364b class1.1		毎時 400~600回の速度で、10,000回の挿抜を行う。										①接触抵抗：初期からの変化量 40mΩ以下 (挿抜により接触抵抗値が復帰すれば可) ②極度の摩耗や破損等の異常がないこと。										○		-														
	振動・高周波 IEC60512-4-6d		片振幅0.75mm、周波数10~55~10Hzの振動をX、Y、Z軸3方向各2時間加える。										①100ns以上の瞬断がないこと。 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。										○		-														
	衝 撃 IEC60512-4-6c		加速度490m/s ² 、持続時間11msの正弦半波で3方向各3回の衝撃を加える。										①100ns以上の瞬断がないこと。 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。										○		-														
環 境 的 性 能	温湿度サイクル IEC60512-6-11m		1サイクル 24時間で 10サイクルの嵌合放置をする。										①接触抵抗：初期からの変化量 40mΩ以下 ②絶縁抵抗：100MΩ以上 ③機能を損なう腐食や破損等の異常なきこと。										○		-														
																																							
備考														製 図		担 当		検 図		承 認		出 図																	
(注1) 通電による温度上昇を含む。 (注2) 接触抵抗は導体抵抗を含む。 規定無き場合は温度15℃~35℃、気圧86~106kPa、湿度25~85%の試験環境下にて実施のこと。																																							
注 QT: 確認試験 AT: 製品検査 ○: 適用項目																																							
 ヒロセ電機株式会社 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.														製品規格表														製品名 DM1AA-SF-PEJ (82)											
旧CL CL														図番 SLC4-153736-04														製品コード CL609-0004-8-82										1/2	

性能				
項目		試験方法	規格	QTAT
環境的 性能	熱衝撃 IEC60512-6-11d	温度 -55～+85℃、変化時間 5分以内で 5サイクル（1サイクル=1h）の嵌合放置をする。	①接触抵抗：初期からの変化量 40mΩ以下 ②絶縁抵抗：100MΩ以上 ③機能を損なう腐食や破損等の異常なきこと。	○－
	耐熱性 IEC60512-6-11i	温度 +85℃に 96hの嵌合放置をする。	①接触抵抗：初期からの変化量 40mΩ以下 ②絶縁抵抗：100MΩ以上 ③機能を損なう腐食や破損等の異常なきこと。	○－
	耐寒性 IEC60512-6-11j	温度 -25℃に 96hの嵌合放置をする。	①接触抵抗：初期からの変化量 40mΩ以下 ②絶縁抵抗：100MΩ以上 ③機能を損なう腐食や破損等の異常なきこと。	○－
	耐湿 （定常状態） IEC60512-6-11c	温度+40℃、湿度 90～95%RH中に96hの嵌合放 置をする。	①接触抵抗：初期からの変化量 40mΩ以下 ②絶縁抵抗：100MΩ以上 ③機能を損なう腐食や破損等の異常なきこと。	○－
	硫化水素ガス JEIDA 38	温度+40℃、湿度80%RH、H ₂ S 3ppmのガス中に 96hの嵌合放置をする。	①接触抵抗：初期からの変化量 40mΩ以下 ②絶縁抵抗：100MΩ以上 ③機能を損なう腐食や破損等の異常なきこと。	○－
	塩水噴霧 JIS C 5402 7.1	温度35±2℃、5±1%の塩水噴霧中に48時間の 嵌合放置をする。（後処理：塩の付着物を水洗 い後、室温に24時間放置）	①機能を損なう腐食や破損等の異常なきこと。	○－

備考

（注1）通電による温度上昇を含む。
（注2）接触抵抗は導体抵抗を含む。
規定無き場合は温度15℃～35℃、気圧86～106kPa、
湿度25～85%の試験環境下にて実施のこと。

製図



担当



検図



承認



出図

注 QT:確認試験 AT:製品検査 O:適用項目

HS ヒロセ電機株式会社
HIROSE ELECTRIC CO., LTD.

製品規格表

製品名
DM1AA-SF-PEJ (82)

旧CL
CL

図番
SLC4-153736-04

製品コード
CL609-0004-8-82

2
2